

1		2										3				4			
가공 ST													수 정 내 용						
													부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일		
ST(기준)													△						
ST(개선)													△						

구분	부품명	수량	재질	표면처리	비고
9	SPRING	1	SUS304	부동태	DSR01057-N/1
8	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00116-5/1
7	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01210-N/1
6	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00036-N/1 (G6007)
5	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00043-5/1 (F6007)
4	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00562-5/1 (F6083)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00462-5/1 (E6017)
2	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01822-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01821-5/1

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차		년월일		2008. 2. 27.			
소수		각도					
분수							
재질		검도		도명			
열처리		제도		BNC-SP-C-FUJIKURA VER.0			
보호파막처리		작성부서		연 구 소		도번	
		적도 3/1		단위 mm		중량	
				A4		도번 CN01265-7/1	
						장종 번째	

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

KJ COMTECH CO., LTD